



CFM56-5B Schweißen des Fan Frame Assy gemeinsam mit dem OEM entwickelt

Zusammen mit GE wurde ein neues CFM56-5B-Verfahren entwickelt, welches uns erlaubt am Fan Frame Assy das Fan Inlet Case zu schweißen, ohne das Modul zu zerlegen.

Was ist passiert?

- Die Vorteile aus diesem neuen Reparaturverfahren kommen aus dem vermiedenen Aufwand für die Zerlegung und den Wiederaufbau des Moduls einerseits und den eingesparten Kosten des Fremdversands von Gehäusehälften.
- Insgesamt verkürzt sich die Verweildauer im Shop um 14 Tage und wir vermeiden Kosten in Höhe von ca. 200 TEUR je betroffenem Event.

Fazit:

- „Dies Verfahren stellt eine Innovation dar, die bis dato seitens des OEM als sehr kritisch und nicht durchführbar gesehen wurde“, erklärt Gerhard Krambeer T/EP24.
- Durch die enge Zusammenarbeit mit dem OEM konnten grundsätzliche Bedenken bei GE durch die LHT-Expertise ausgeräumt werden. Es konnte eine weitergehende technologische Zusammenarbeit bei dieser komplexen Thematik vereinbart werden.
- „Neben dem tollen Zusammenspiel aller Fachbereiche im Team, gilt der besondere Dank den Kollegen in den Produktionsbereichen, die durch ihr Engagement und ihre Flexibilität die Umsetzung dieser Entwicklung erst möglich gemacht haben. Wir haben bei GE einen sehr positiven und kompetenten Eindruck hinterlassen“, freut sich Dr. Claus Bauer, T/EP.



Das Projektteam (von links): Mareike Philipp T/EMZ, Jochen Knapp T/ES23, Grzegorz Maraszkiwicz GE, Waldemar Piosik GE, Pawel Czarnecki GE, Sergio Mattana T/EM331, Gerhard Krambeer T/EP24, Olaf Berend T/EM353